



全世界领先元器件制造商的选择

冲孔机

PAM - 系列



- 生瓷片上冲通孔和定位孔
- 可适合大多数形状设计的孔
- 可支持程序的手工输入，CAD 导入，NcDrill 文件和 DXF 文件
- 冲针破损检测功能
- 预冲孔的自动对中功能

适用于量产和研发型 LTCC 产品生产

基本特点:

PAM-S 系列冲孔机设计用于 LTCC和HTCC 基板的打孔，可用于冲制各种类型孔。PAM-S 系列使用单冲针在生陶带，载带，或光膜带上冲制通孔或定位孔。

由于是机械冲孔，所以每种孔尺寸均要对应一种冲针的尺寸。依据设备具体型号，本系列冲孔机可安装多大至 4 根针或 8 根针（每根针对应一种孔尺寸）。

也可支持特殊的多针系统（针床模式）可最大限度的提升生产效率。该系列产品有多种型号可选，包括操作者手工放料片机器按照程序进行拾取操作的基础型号到带裁片功能然后自动传递到上料器的全自动版本。机器带有冲针损伤检查和基于预制孔的视频对中系统。

单针工具		多针模组工具
气动	伺服电机	最大面积 45 x 45 mm 圆针之间的距离最大 6 mm 最大冲模 1 mm
圆针 0.1 - 5 mm	圆针 0.1 - 3 mm	
方针 0.5 x 0.5 - 3 x 3 mm	方针 0.5 x 0.5 - 3 x 3 mm	

技术规格

冲孔速度	20孔/s 在1 x 1 mm范围内	断针检测	通过CCD和视像控制（每个孔，最后一个孔）
打孔面积	最大 225 x 225 mm ; (9 x 9 英寸)	膜片固定	通过真空，可选金属框固定
膜带厚度	达 500 um (20mils) (需验证)	换针	小于 2 分钟
X,Y 驱动	高精度丝杆及伺服电机	控制	PC
位置精度	+/- 5 um	选配	真空泵
程序	在机器上手动编程 或 CAD 导入 (NcDri II 或 DXF)	膜片上料方式	操作员手动上勾，自动从料盒上下料，卷状上料，片状下料至料盒
载带厚度	20 至 70um (0.8 至 3 mils)	安全	CE 认证

如何选型: *

PAM-x x

膜片上料 - 手动M
- 料盒至料盒CC
- 卷状至料盒RC

冲孔工具数量 (4 或 8)
必须单独指定打孔工具

打孔机

* 选配和其它需求需要单独区分开



Grajski trg 15, 360 Zuzemberk, Slove
nijaT +386 7 3885 200
F +386 7 3885 203
info@keko-equipment.com
www.keko-equipment.com